

## VITROX 的 SMT 和后端半导体行业的机器视觉检测解决方案!

Wednesday, 9 August 2017

伟特科技 (ViTrox Technologies) 公司今天宣布, 将参展 2017 年 8 月 29 日-31 日在深圳会展中心隆重举行的 NEPCON 华南 (NEPCON South China) 电子展, 展位号: #1C20。

ViTrox 将会展出其获奖及最畅销的产品之一, 先进光学检测机台 V510i Optimus 3D AOI。V510i 3D AOI 的摄像机已增强至 1200 万像素并保证高检测素质及分辨率。V510i 3D AOI 的检测速度及分辨率也同步提升至 60cm<sup>2</sup>/sec 和 15μm。同时, V510i 3D AOI 采用 2D + 3D 检测, 以达到高生产率和无可检测性。此外, 它还可以检测许多挑战性的缺陷如翘脚, 共面性, 黑色电路板 / 多色电路板, 存在/缺件和诸如 01005/0201 等小部件。V510i 3D AOI 现还提供相称的双轨以检测更大的电路板。



此外, 另一个展示产品是热销的先进 3D X-Ray 检测机台, V810i S2EX。V810i S2EX 可检测 482mm x 609mm 的电路板, 比之前检测的面积大 10%! 它支持高达 4.5 kg 的基板重量和 7mm 厚度的基板尺寸。系统检测面积也提高到 18.7" x 24"。V810i S2EX 的重点介绍是其智能优化扫描路径 (SPAM), 可减少检测时间和硬件扫描路径, 其单一核心管理 (SUMO) 使用具有 128GB RAM 的 8 核处理器, 将系统加速到最佳性能水平。同步高效重建技术 (SERT) 和新的 64 位成像处理器结合与实时计算精准的切层高度 (PSH) 形成单个扫描路径, 相移轮廓技术 (PSH) 使用内设投影机将投影和图像采集速度提高至 10 倍。

ViTrox 的 V310i 3D SPI 系统可检测 510 mm x 505 mm 的电路板。它可以在高速模式下准确检测焊点的相关缺陷。V310i 3D SPI 可编程的 Spatial Light Modulation (PSLM) 技术淘汰了机械操作和移动部件, 与当前市场上的其他焊膏检测技术相比, 大大提高了使用方便性和可靠性, 降低了维修成本。获专利的 D-Lighting 实现了全光谱检测, 旨在解决 3D 测量期间的阴影效应和减少噪声干扰。

V-ONE 是 ViTrox 近年来大力推出的最新解决方案, 它将所有过去的和未来的 ViTrox 软件组成一个解决方案套件, 连接 SMT 生产线检测设备, 以实时监控它们的性能表现。V-ONE 可使用户更智能地管理工厂, 跨地理位置优化工厂资源。



此外, ViTrox 还会展示用于后端半导体检测 TH1000i 托盘式视检系统。TH1000Si 采用先进的关键技术, 为托盘中的 BGA, QFN, CSP, TSSOP, MSOP, SOP IC 封装提供高速, 高精度, 一站式视觉检测解决方案。TH1000Si 的 16 支吸嘴可提高机器的吞吐量至 42K。其自动间距调整可提供更快更准确的吸嘴间距调整。

届时, 伟特科技的技术专家将会在场协助任何查询, 并欢迎您到场享受我们产品的现场演示。请不要错过这个黄金机会来体验 ViTrox 的新技术!